

吸収分割公告

2023年2月27日

債権者各位

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
株式会社日立ハイテク
代表取締役 飯泉 孝

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
株式会社日立ハイテクソリューションズ
代表取締役 三浦 英俊

株式会社日立ハイテク（以下、「甲」という。）は、吸収分割により、株式会社日立ハイテクソリューションズ（以下、「乙」という。）の産業インフラ事業のうち、ハードディスク・フラットパネルディスプレイ事業、ラボソリューション事業およびICT事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させること（以下、「本吸収分割」という。）にいたしましたので、下記のとおり公告いたします。

本吸収分割の効力発生日は2023年4月1日であり、甲は会社法第796条第2項、乙は会社法第784条第1項に基づき株主総会の承認決議を経ずに決定いたしております。

記

1. 本吸収分割に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申し出ください。
2. 甲および乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 - (甲) <https://www.hitachi-hightech.com/jp/>
 - (乙) <https://www.hitachi-hightech.com/hs1/>

以上